

大電流対応厚銅基板

Heavy Copper PWB

特長 Features

- 大電流ユニットに対応
Correspondence to Large Current unit
- 銅厚: $175\mu\text{m}$ ~ $210\mu\text{m}$
Copper Thickness: $175\mu\text{m}$ ~ $210\mu\text{m}$
※内層 $210\mu\text{m}$ (開発中)

用途 Application

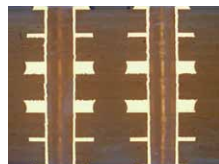
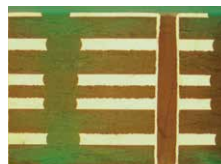
ジャンクションボックス / 電源モジュール / 電源充電器 / インバーター / コンバーター / トランス / UPS など

基板仕様 PWB specification

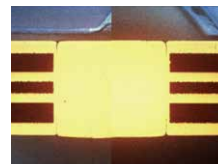
内層導体厚 Inner Layer Conductor Thickness	層構成 Layer Construction	板厚 Board Thickness	最小導体幅 Min conductor Width	最小導体間隔 Min Conductor Spacing
$175\mu\text{m}$	4層貫通 6層貫通	~ 3.0mm (層構成により変動)	$400\mu\text{m}$	$400\mu\text{m}$
R&D $210\mu\text{m}$	4層貫通 6層貫通	~ 3.0mm (層構成により変動)	$450\mu\text{m}$	$450\mu\text{m}$



量産中 6層貫通 内層 $175\mu\text{m}$ /充電設備



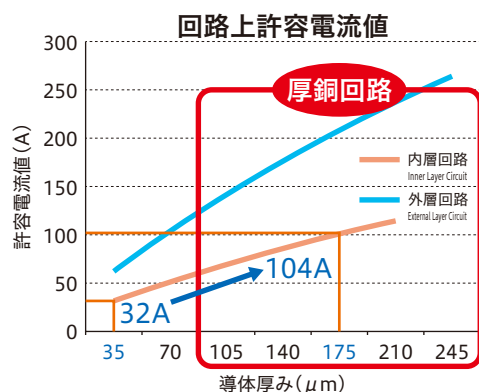
R&D 6層貫通 内層 $210\mu\text{m}$



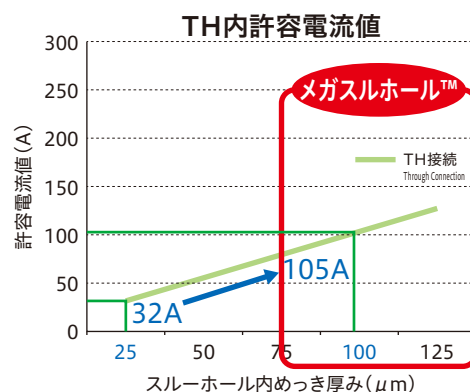
R&D 銅インレイ技術との組み合わせ

許容電流値 Current-Carrying Capacity

一般的な導体厚($35\mu\text{m}$)の許容電流値は 32A となりますが、導体厚を $175\mu\text{m}$ にすることで許容電流値を 100A まで向上させる事が可能となります。更に弊社新技術『メガスルホール™』と厚銅基板を組み合わせることで立体的な回路配線においても大電流化が可能となります。



上昇温度 ΔT Temperature Rise	10°C
配線幅 Conductor Width	$400\mu\text{m}$



上昇温度 ΔT Temperature Rise	10°C
仕上がり穴径 Finished Hole Diameter	$\phi 0.40\text{mm}$
穴数 The Number of Holes	52穴



※基板単体における単独配線を想定したシミュレーション結果であり、お客様での製品時点での結果ではありません。